

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-072

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意，公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 12,016,745.28 元，实际募集资金净额为 1,162,983,254.72 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 15 日出具了《验证报告》（天健验[2025]6-4 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司、子公司已

与保荐机构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	116,298.33
截至期初累计发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）
	利息收入、理财收益净额
本期发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）
	利息收入、理财收益净额
截至期末累计发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）
	利息收入、理财收益净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ^[注]	18,433.62

[注] 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额包含购买理财产品尚未到期金额 10,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站分别披露了《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监

管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	余额(万元)
上海伟测半导体科技股份有限公司	兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	2.72
	中信银行上海分行	8110201011501885643	5.04
	交通银行上海张江支行	310066865013009418191	10,289.44 ^[注]
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310018	7,573.04
南京伟测半导体科技有限公司	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006600013004712605	563.38

【注】该募集专户余额包含截至 2025 年 6 月 30 日购买理财尚未到期金额 10,000.00 万元。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目无法单独核算效益，尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

2、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目 2024 年 12 月达到预定可使用状态，但截至 2025 年 6 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

3、偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2025]6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 1 亿元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托机构	产品类型	购买金额	期限	收益类型	收益	是否赎回
交通银行上海张江支行	结构性存款	10,000.00	2025/06/03-2025/08/05	保本浮动收益		否
	7天通知	16,600.00	2025/04/30-2025/05/11	保本固定收益	0.55	是
	结构性存款	10,000.00	2025/05/06-2025/05/27	保本浮动收益	9.49	是
招商银行无锡分行新区支行	7天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	保本固定收益	1.56	是
	7天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	保本固定收益	1.33	是
	14天结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	保本浮动收益	2.08	是
	7天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	保本固定收益	0.83	是
	7天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	保本固定收益	1.15	是
	7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	保本固定收益	0.44	是
	7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	保本固定收益	0.94	是

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年1-6月,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年1-6月,公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(九) 节余募集资金使用情况

2025年1-6月,公司不存在节余募集资金使用情况。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意使用可转换公司债券募集资金11,061.98万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目,以及使用可转换公司债券募集资金1,511.99万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目。实际借款金额包括该笔募集资金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额,具体金额以实际

转出金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-031）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2025 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年 1-6 月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				117,500.00 ^[注]		本年度投入募集资金总额				97,892.76		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				97,892.76		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	62,435.64	62,435.64	-7,564.36	89.19	2027年10月	不适用	不适用	否
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,436.71	19,436.71	-563.29	97.18	2024年12月	不适用	不适用	否

偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	16,020.42	16,020.42	-11,479.58	58.26	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	117,500.00	117,500.00	117,500.00	97,892.76	97,892.76	-19,607.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详情请见报告正文“三、（四）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详情请见报告正文“三、（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成的原因					截至本报告期末募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况					详情请见报告正文“三、（十）募集资金使用的其他情况”							

注：本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。